

广发证券股份有限公司

关于杭州朗迅科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市

之

上市保荐书



二零二六年九月

声 明

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”、“保荐人”或“保荐机构”）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。

如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《杭州朗迅科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》一致。

目 录

声 明.....	1
目 录.....	2
第一节 本次证券发行基本情况	3
一、发行人基本情况	3
二、本次证券发行的基本情况	12
三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况	13
四、发行人与保荐人的关联关系	14
第二节 保荐机构的承诺事项	16
一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。	16
二、本保荐机构自愿接受深圳证券交易所的自律监管。	16
第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见	17
一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论	17
二、本次证券发行上市所履行的程序	17
三、发行人符合板块定位及国家产业政策的核查情况	18
四、本次发行符合上市条件	22
五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排	26
六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式	27
七、保荐机构认为应当说明的其他事项	27

第一节 本次证券发行基本情况

一、发行人基本情况

（一）发行人基本信息

公司名称	杭州朗迅科技股份有限公司
英文名称	Hangzhou Luntek Technology Co.,Ltd.
法定代表人	徐振
注册资本	4,292.1560 万元
成立日期	2010 年 5 月 14 日
注册地址	浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢（南）5 楼 E5029 室
办公地址	浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 1 幢（南）5 楼 E5029 室
联系人	夏丽君
邮政编码	310053
互联网网址	https://www.luntek.com.cn
电话	0571-8668 1836
传真	/
电子邮箱	IR@luntek.cn
所属行业	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
经营范围	一般项目：集成电路制造；集成电路销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子元器件批发；电子元器件制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）发行人的主营业务

公司是最大的内资第三方集成电路测试企业，专注于第三方集成电路测试业务，在集成电路国产化、产业链自主可控的浪潮下，为国产高端芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）服务。公司凭借优秀的自主研发能力和强大的产业化落地能力，顺应先进工艺和先进封装的行业趋势，持续助力高端芯片测试的国产化替代，为客户提供包括晶圆测试（CP）、

成品测试（FT）、老化测试（BI）、系统级测试（SLT）、工程测试服务等在内的一站式芯片量产测试解决方案。公司测试的芯片产品包括算力芯片、高性能 SoC 芯片、光学芯片、车载芯片、射频芯片、传感器芯片等多种芯片类型，下游应用聚焦高端算力、消费电子、车载智控、通讯及工控等重要领域，同时还覆盖导航通信、智能家居、穿戴设备等多个重要场景。

报告期内，公司的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

项目		2025 年度		2024 年度		2023 年度	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比
量产测试	FT	97,895.60	48.14%	53,404.88	51.46%	24,171.98	49.87%
	CP	61,731.51	30.36%	25,517.79	24.59%	13,189.12	27.21%
	小计	159,627.11	78.50%	78,922.67	76.05%	37,361.10	77.07%
工程测试服务		43,715.47	21.50%	24,856.34	23.95%	11,112.72	22.93%
合计		203,342.58	100.00%	103,779.01	100.00%	48,473.82	100.00%

（三）发行人的主要经营和财务数据及指标

报告期内公司主要财务指标情况如下：

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
资产总额（万元）	836,223.08	567,858.70	305,858.08
归属于母公司所有者权益（万元）	231,532.12	166,951.16	104,571.18
资产负债率（母公司）	19.46%	7.41%	6.53%
资产负债率（合并）	71.37%	69.19%	63.20%
营业收入（万元）	206,430.25	108,728.04	53,553.63
净利润（万元）	61,972.16	20,266.39	9,941.85
归属于母公司所有者的净利润（万元）	62,046.98	20,251.37	9,959.12
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	53,457.09	13,358.44	5,902.13
基本每股收益（元）	14.46	5.28	2.78
稀释每股收益（元）	14.40	5.28	2.78
加权平均净资产收益率	31.14%	17.65%	14.97%

项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度	2024 年 12 月 31 日/2024 年度	2023 年 12 月 31 日/2023 年度
经营活动产生的现金流量净额（万元）	175,882.16	48,938.12	82,265.23
现金分红（万元）	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	7.46%	9.39%	12.47%

上述指标的计算公式如下：

（1）资产负债率=负债总额/资产总额

（2）加权平均净资产收益率= $P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Ek 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期期末的月份数。

（3）基本每股收益= $P \div S$

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

（4）稀释每股收益= $[P + (已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 - 转换费用) \times (1 - 所得税率)] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)$ 。

其中，P 为归属于公司普通股股东的净利润。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

（5）研发投入占营业收入的比例=研发费用/营业收入

（四）发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）经营风险

1）客户集中度较高且第一大客户占比较大的风险

报告期内，公司向前五大客户销售金额占营业收入的比例分别为 93.75%、96.55%和 98.22%，集中度较高。其中，对 A 公司的销售收入占公司营业收入的比例分别为 87.05%、86.49%和 92.57%，公司存在客户集中度较高的风险。

公司客户集中度较高主要受下游行业竞争格局及自身业务发展影响。公司主要客户 A 公司是全球领先的半导体与器件设计公司，产品线广泛，具备雄厚的技术积累，在国产集成电路领域具有较高行业地位。

报告期内，公司积极进行其他客户的业务拓展，但由于近年来 A 公司业务规模及测试需求的快速增长，对 A 公司的收入占比仍然较高。如果未来公司以第一大客户为代表的主要客户由于市场竞争、宏观经济波动以及自身产品等原因经营情况发生重大不利变化，或由于受到外部贸易限制导致订单需求下降，抑或公司因为测试服务质量等原因影响与主要客户的业务往来，使得客户自身经营稳定性及与公司业务的持续性受到损害，将对公司的经营产生不利影响。

2) 供应商集中度较高的风险

报告期内，公司对前五大供应商的采购额占采购总额的比例分别为 80.82%、77.27%和 77.11%，集中度较高，但不存在对单一供应商采购超过 50%或严重依赖少数供应商的情形。集成电路测试业务需要较多的测试设备投入，主要采购测试机、探针台、分选机等测试设备及相关配件。集成电路测试设备行业生产厂商数量整体较为有限，能够满足高端芯片测试需求的设备厂商数量更少，现有主要设备供应商包括较少数量的国际知名厂商，以及 D 公司等国产设备厂商。公司供应商较为集中主要系行业上游格局、集成电路产业国产化需求及公司持续扩产等因素所致。尽管公司与主要供应商建立了良好的合作关系，且主要设备均有不止一家供应商储备，但若未来各类不利事件集中发生或产业及行业发生重大不利转变等，导致公司与现有供应商的合作受到重大影响，而公司未及时落实新的供应商开拓和储备、无法及时实现供应体系的更新和替代，则将对公司经营产生不利影响。

3) 公司发展需持续投入大量资金的风险

集成电路测试行业，尤其是高端芯片测试对生产设备及产线的精细化、自动化要求较高，相关设备单价通常处于较高金额区间，导致固定资产投资规模较大，对行业进入者构成了较高的资金门槛。随着生产规模的持续扩张，公司对于设备及资金投入需求持续提升。为进一步满足持续增长的测试需求，公司需要配置充足的测试产能及对应的测试平台，对于资金投入需求较高。

截至 2025 年末，公司固定资产金额为 494,347.48 万元，占公司总资产的比例为 59.12%。报告期内，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为 81,691.92 万元、173,616.63 万元和 229,866.14 万元。如果公司未来

不能取得足够的经营收益，或融资渠道、规模受限，导致发展资金短缺，可能对公司的持续发展和市场竞争力造成不利影响。

4) 经营业绩增速放缓或下滑风险

报告期内，公司营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元，增长率分别为 103.03%和 89.86%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为 5,902.13 万元、13,358.44 万元和 53,457.09 万元，经营业绩增长较快，且已经具有较大规模。

随着公司业绩规模的扩大，后续同比增长幅度或将有所降低，同时公司经营业绩受到下游市场发展趋势、主要客户测试需求、供应商选择、公司自身产能等因素影响，未来若公司未能保持自身竞争优势、测试技术无法满足持续进步的国产半导体测试需求或主要客户未来终端产品市场需求下降，可能导致公司未来经营业绩存在增速放缓或下滑的风险。

(2) 财务风险

1) 主营业务毛利率波动的风险

报告期各期，公司集成电路测试业务毛利率分别为 39.25%、35.86%和 45.37%，毛利率存在一定程度的波动。公司毛利率受产能利用情况、测试业务结构、固定资产折旧、人力成本、测试方案等因素影响。报告期内，公司紧跟下游发展持续加大投入、投建新产能，测试的芯片产品也随着国产集成电路高端应用领域的发展而不断更新升级。若未来上述因素发生不利变化，如公司无法跟进市场发展，测试设备折旧、人力成本等上升过快，收入结构中毛利率较高的业务类型占比减少，或公司产能利用率严重下降等情况发生，则公司主营业务毛利率可能存在下滑风险。

2) 固定资产折旧金额较大的风险

报告期各期，公司固定资产折旧金额分别为 12,394.92 万元、23,031.90 万元和 41,382.91 万元，占同期营业收入的比例分别为 23.14%、21.18%和 20.05%，占比相对较高。截至 2025 年末，公司固定资产原值为 56.84 亿元，其中专用设备的原值为 48.84 亿元，为固定资产的主要构成。

报告期内，公司经营规模处于快速增长态势，产能规模不断扩大，固定资产持续投入。若后续因市场环境产生重大不利变化，或公司因管理不善等原因导致无法充分利用现有固定资产，综合效益提升无法抵消折旧费用，将会对公司业绩产生不利影响。

3) 净资产收益率和每股收益下降的风险

报告期各期，公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净资产收益率分别为 8.87%、11.64%和 26.83%，基本每股收益分别为 1.65 元、3.49 元和 12.45 元，呈现持续增长态势。本次发行完成后，公司净资产及股本将有所增加，鉴于募集资金投资项目存在一定建设周期，产生效益需要一定时间，因此，公司在短期内存在净资产收益率和每股收益下降的风险。

4) 税收优惠政策变化风险

根据《中华人民共和国企业所得税法》《关于促进集成电路产业和软件产业高质量发展企业所得税政策的公告》《财政部税务总局关于集成电路企业增值税加计抵减政策的通知》，公司主要经营主体享受了高新技术企业优惠所得税率、集成电路企业所得税“两免三减半”、增值税进项税加计抵减等优惠政策。报告期内，公司经营业绩主要来源于主营业务，对税收优惠不存在重大依赖，但若未来国家优惠政策收紧，或公司主要经营主体未能持续满足相关税收优惠政策的条件，将会对公司经营业绩带来一定不利影响。

5) 政府补助变动风险

报告期各期，公司计入其他收益的政府补助金额分别为 3,970.32 万元、6,493.01 万元和 8,954.48 万元，主要包括设备及厂房补贴、创新项目奖励、中小企业发展专项补助等。公司报告期内扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 5,902.13 万元、13,358.44 万元和 53,457.09 万元，主营业务经营情况良好，但若未来政府部门对公司所处产业的支持力度减弱，公司获得的政府补助大幅减少或无法取得相关补助，则可能会对公司经营业绩造成一定不利影响。

6) 偿债风险

报告期各期末，公司流动比率分别为 0.87、0.92 和 1.22，速动比率分别为 0.85、0.90 和 1.19，合并报表资产负债率分别为 63.20%、69.19%和 71.37%，公

司资产负债率相对较高且逐渐增加，经营活动现金流量净额分别为 82,265.23 万元、48,938.12 万元和 175,882.16 万元。鉴于公司未来仍将持续扩大生产经营规模，资金需求量也将不断增加，若公司不能有效进行资金管理，则会面临一定资金压力和偿债风险。

（3）创新及技术风险

1）测试技术更新迭代不及时，无法满足持续进步的国产半导体测试需求风险

近年来，国产半导体制程工艺持续进步，测试技术持续迭代升级，2.5D 及 3D 封装、Chiplet 封装等先进封装技术带来的一系列集成电路测试需求不断涌现，要求行业内企业快速响应市场、技术及客户需求的变化形势，持续进行研发投入，提供能够符合客户技术要求并具备较强市场竞争力的测试服务。

公司在集成电路测试领域持续投入资源开展研发活动，紧跟行业、技术及市场形势。但由于集成电路行业的快速发展和国产技术的持续迭代，仍面临技术更新不及时的风险。如果公司未来技术迭代不及时或测试效果不达预期，无法满足客户的测试需求，则可能对公司的经营业绩产生不利影响。

2）研发技术人员流失的风险

集成电路测试属于人才、技术密集型行业，测试方案开发与导入、测试量产工艺优化等均有赖于具备丰富专业知识和工程经验的研发技术人员。公司经过多年的产业积累，已经建立了专业的研发技术团队，并建立了完善的薪酬及激励机制。与此同时，随着集成电路市场规模的快速增长，行业内对于人才的竞争将愈发激烈，如果公司不能持续吸引行业优秀人才，不能打造和维持与业务发展相适应的研发团队，可能会面临研发技术人员流失的风险，进而对公司的研发及持续经营能力产生一定不利影响。

3）核心技术及知识产权泄露风险

经过在集成电路测试行业持续的研发积累，公司已经掌握并应用了多项测试核心技术并取得自主知识产权，相关技术体系是公司整体竞争力的重要构成和保障。公司高度重视对于核心技术的保护工作，与核心技术人员签署了保密协议，积极申请知识产权进行成果保护，并建立了技术相关的内控制度和严格的保密制

度。但未来如果公司相关内控制度未得到有效执行而导致出现核心技术泄密的情况，则可能损害公司的核心竞争力。

2、与行业相关的风险

（1）行业需求波动风险

集成电路测试是集成电路制造的必要环节，在垂直分工模式下，公司作为第三方集成电路测试服务厂商与集成电路行业整体发展高度相关。集成电路行业服务和渗透于国民经济的各个领域，且其生产制造涉及广泛的产业链协同，行业需求受到宏观经济形势、贸易壁垒等多种因素的影响。近年来，人工智能、汽车电子、5G 通讯等前沿领域需求增长，国际政治经济和贸易形势纷繁扰动，境内集成电路市场需求和产能在此环境下快速增长。但如果后续宏观经济增长放缓、国际政治经济环境巨变，造成集成电路行业或公司主要客户需求减少，将对公司业绩持续增长带来一定的不利影响。

（2）集成电路测试行业的竞争风险

集成电路测试服务的主要提供方包括第三方测试服务企业、封测一体企业两大类。中国境内第三方测试行业处于快速增长阶段，但与封测一体模式相比起步仍相对较晚，行业内现有企业相对于长电科技、通富微电等代表性封测一体企业规模相对较小，在收入体量、客户覆盖范围、资金实力等方面仍有一定距离；同时，京元电子、矽格、欣铨等全球范围内的第三方测试巨头亦具备较大的业务规模、深厚的技术积累和广泛的全球大型客户服务经验，测试行业竞争风险较为显著。

随着集成电路市场规模的扩张、垂直分工模式的深化和供应链本土化趋势的加速，境内集成电路测试需求持续稳定增长，政府部门也加大了包括测试行业在内的半导体领域的政策扶持力度，行业内第三方测试企业、封测一体企业持续增加资金及资源投入，市场竞争日趋激烈。若公司未来无法持续保持较强的市场竞争能力，则有可能在市场竞争中处于不利地位。

3、募集资金投资项目风险

(1) 募投项目实施风险

本次募集资金金额及投资项目综合考虑了行业和市场状况、技术水平及发展趋势等因素，并对可行性进行了充分论证，具备合理性。但公司募投项目投资规模整体较大，且涉及较大规模的工程建设、设备投入等，对公司项目管理及实施能力提出了较高的要求。如公司无法有效实施项目进度管理、管控项目投资成本，或外部市场环境发生较大变化，则可能对募集资金投资项目实施产生不利影响。

(2) 关于募投项目新增产能无法消化的风险

本次募集资金计划投资于杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目、越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目以进行测试产能扩充，拟使用募集资金 52.00 亿元投资前述项目。项目达产后，公司集成电路测试能力预计将得到显著提升。相关项目规划系基于行业需求、公司整体发展战略及产销情况等整体合理规划确定，并已经根据项目计划做好了人才储备、营销管理等一系列准备工作，但新增产能消化受到行业需求、技术发展、客户需求等多种因素影响，如果相关因素出现重大不利变化，公司可能面临本次募投项目新增产能无法消化的风险。

(3) 新增折旧摊销及摊薄即期回报的风险

本次发行募集资金到位后，公司固定资产、总股本及净资产将大幅增长。考虑到募投项目需要一定的建设及产能爬坡周期，无法立即实现预期效益，募集资金到位后短时间内可能导致公司每股收益、净资产收益率等指标被摊薄。同时，募投项目建设预计新增生产设备和研发设备等，新增较大规模的折旧及摊销金额，如果因市场环境等因素变化，导致募投项目达产后整体盈利水平不及预期、无法弥补新增固定资产带来的折旧费用，则可能对公司盈利能力造成不利影响。

4、其他风险

(1) 公司规模扩张带来的管理风险

近年来公司经营规模快速增长，报告期内营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元，最近三年复合增长率为 96.33%。本次发行完

成后随着募集资金投资项目的实施与落地，公司业务、资产及人员规模预计将进一步扩大，将对公司经营管理能力和内部控制体系提出更高的要求和挑战。未来如果公司整体经营管理水平不能随着资本市场要求、业务规模的扩张而持续提升，或者内部控制制度不能持续有效执行，将对公司的经营效率和发展质量带来不利影响。

（2）发行失败风险

本次发行的结果将受到证券市场整体情况、发行人经营业绩、投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。若存在投资者认购不足或其他影响发行的不利情形，可能导致本次发行面临发行失败的风险。

二、本次证券发行的基本情况

股票种类	人民币普通股（A 股）		
每股面值	人民币 1.00 元		
发行股数	不超过 1,430.7187 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
其中：发行新股数量	不超过 1,430.7187 万股	占发行后总股本比例	不低于 25%
股东公开发售股份数量	不适用	占发行后总股本比例	不适用
发行后总股本	不超过 5,722.8747 万股		
每股发行价格	【】元		
发行市盈率（标明计算基础和口径）	【】（发行价格/每股收益，每股收益按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者净利润除以发行后总股本计算）		
发行前每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计的归属于母公司所有者的净资产除以本次发行前总股本计算）	发行前每股收益	【】元（按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	【】元（按【】年【】月【】日经审计后的归属于母公司所有者的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）	发行后每股收益	【】元（按【】年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以发行后总股本计算）
发行市净率（标明计算基础和口径）	【】（按每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算）		
发行方式	采用网下向询价对象配售发行和网上资金申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会要求或认可的其他方式		
发行对象	符合资格的询价对象和已开立深圳证券交易所股票交易账户并开通主板交易的境内自然人、法人以及符合证券监管机构规定的其他投资		

	者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
募集资金总额	【】
募集资金净额	【】
募集资金投资项目	杭州芯光人工智能及终端消费芯片测试全国战略基地项目
	越芯半导体高端智能终端与车规级芯片先进测试基地项目
	总部研发大楼项目
	补充流动资金项目
发行费用概算	本次发行费用总额为【】万元，其中承销保荐费【】万元、审计及验资费【】万元、律师费【】万元、用于本次发行的信息披露费【】万元、用于本次发行的发行手续费及材料制作费等其他费用【】万元

三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况

（一）本次证券发行上市的保荐代表人情况

广发证券指定周天宇、郑睿担任本次朗迅科技首次公开发行股票并在主板上市的保荐代表人。前述两位保荐代表人的执业情况如下：

周天宇，保荐代表人、清华大学硕士。曾负责完成万胜智能 IPO 项目、博俊科技非公开发行股票项目、纵横通信 IPO 项目及公开发行可转债项目、甘李药业 IPO 项目、顶点软件 IPO 项目、天成自控 IPO 项目及非公开发行股票项目，参与完成联得装备 IPO 项目、恒华科技 IPO 项目、荣信股份公司债项目、欧菲光公司债项目，拥有丰富的投资银行业务经验。

郑睿，保荐代表人、注册会计师，清华大学学士、硕士，曾担任泰鸿万立、志高机械、光大同创、浙江自然、海晨股份、万胜智能、顶点软件、联得装备、天成自控、恒华科技等多个 A 股 IPO 项目的负责人或保荐代表人，拥有丰富的投资银行业务经验。

（二）本次证券发行上市的协办人情况

张李展，复旦大学学士、硕士，曾参与泰鸿万立等 IPO 项目以及海晨股份向特定对象发行股票、博俊科技向特定对象发行股票等多个再融资项目，具有较为丰富的投资银行项目执行经验。

（三）项目组其他成员情况

本次证券发行项目组其他成员包括李雨晴、谭昕昀、任文渊、王政杰、安浩恺、蒋东儒、庞力源、王伟、李丹、杜俊涛。

四、发行人与保荐人的关联关系

（一）保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，保荐人广发证券全资子公司广发乾和、广发信德管理的私募基金珠海格金合计持有发行人 2.95%股份。除前述情况外，本保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有或者通过参与本次发行战略配售持有发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（二）发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况

截至本上市保荐书签署日，除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，发行人及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况。

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、取消监事会前监事、高级管理人员，持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职的情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、取消监事会前监事、高级管理人员未持有发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，也未在发行人或其控股股东、实际控制人及重要关联方任职。

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

截至本上市保荐书签署日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方不存在相互提供担保或者融资等情况。

（五）保荐人与发行人之间的其他关联关系

截至本上市保荐书签署日，本保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在其他关联关系。

第二节 保荐机构的承诺事项

一、本保荐机构已按照法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本保荐机构同意推荐发行人证券发行上市，并具备相应的保荐工作底稿支持。

二、本保荐机构自愿接受深圳证券交易所的自律监管。

第三节 保荐机构对本次证券发行上市的推荐意见

一、本保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论

广发证券股份有限公司接受发行人委托，担任其本次首次公开发行股票保荐机构。本保荐机构遵照诚实守信、勤勉尽责的原则，对发行人进行了全面调查，充分了解发行人的经营状况及其面临的风险后，本保荐机构认为：

发行人本次公开发行股票符合《公司法》《证券法》和《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称《首发管理办法》）《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律法规、部门规章的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所主板上市的条件。广发证券同意对发行人首次公开发行股票并在主板上市予以保荐。

二、本次证券发行上市所履行的程序

（一）发行人董事会审议通过

2026年5月21日，发行人召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》《关于制订<公司股票上市后三年的股东分红回报规划>的议案》《关于审议<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（二）发行人股东会审议通过

2026年5月30日，发行人召开2026年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票并上市的议案》《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行股票并上市有关具体事宜的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配政策的议案》《关于制订<公司股票上市后三年的股东分红回报规划>的议案》《关于审议<公司股票上市后三年内公司股价稳定预案>的议案》等与本次发行上市相关的议案。

（三）发行人决策程序的合规性核查结论

本保荐机构认为，发行人本次发行上市履行了《公司法》《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所规定的决策程序。

三、发行人符合板块定位及国家产业政策的核查情况

（一）发行人符合主板的定位要求

1、发行人业务模式成熟、稳定

报告期内，公司主要业务模式均保持稳定、未发生变化，且成熟度较高，与行业内主要厂商不存在显著差异。发行人自成立以来即投身于集成电路相关行业，报告期内主要业务为第三方集成电路测试服务。公司销售模式、采购模式、生产模式等主要经营模式系由长期产业实践形成，且与行业通用业务模式整体一致。具体情况如下：

（1）销售及盈利模式

公司为第三方集成电路测试服务商，测试业务采用直销的模式开展销售，为客户提供晶圆测试、成品测试服务等并取得测试服务收入。

集成电路测试业务由公司营销中心整体负责，通过专业的销售服务团队开展客户沟通维护、销售报价、合同签署等工作，并协同公司制造中心、质量中心完成具体测试安排及商务条款的确定。测试业务的合作关系建立及业务导入所需周期通常较长，公司通常与客户开展长期业务合作，营销中心会持续跟进各测试项目进度、对账结算以及客户关系维护等系列工作。

在销售定价方面，营销中心与客户经过洽谈后确定测试服务价格。由于不同客户及产品的测试方案均具有差异性，通常涉及不同测试站点及设备配置，公司基于所需测试设备、具体测试方案的测试难度和测试工艺要求、订单规模、测试时长等因素进行综合定价。

（2）采购模式

公司在综合考虑供应链自主可控、采购及生产稳定性的基础上开展采购，内容主要包括测试设备、测试治具等。其中，测试设备为主要采购内容，主要根据产能需求、设备交期、公司投资安排等情况由公司直接采购；测试治具包括探针

卡、测试座等，**主要根据订单及生产需求由公司采购。**

公司采购按照相关采购规章制度执行，由供应链中心等需求部门结合生产计划及发展规划提出采购需求，经过审批后按照采购物资的技术、质量要求选取合格供应商。公司高度重视供应链安全与稳定，建立了较为完善的供应商筛选与管理体系，由供应链中心、质量中心等对供应商的准入、定期评估、产品质量检测等进行协同管理，确保采购产品品质、设备及物料交期等符合公司要求。

(3) 生产及服务模式

公司采取“以销定产”的生产模式，实行订单式生产，并对各经营主体的测试产能进行总体控制与灵活管理，保障测试作业的顺利完成。公司集成电路测试服务主要由制造中心下属的各个测试主体承担，各业务部门配合完成。具体业务开展过程中，由营销中心根据客户订单及来料情况，在内部生产管理系统中投单排产，制造中心依据排产安排进行产品测试。

公司建立了较为完善的生产管理制度，并设置了质量中心对成品交付质量进行把控、监督，对测试效果、交付及时性等进行持续优化，确保公司测试服务质量。

(4) 研发模式

公司高度重视研发创新对于业务开展的引领作用，以行业技术发展趋势和产业化探索过程中的问题解决为导向，聚焦集成电路测试领域研发工作，不断迭代提升自身测试技术水平，打造了具备自主知识产权的集成电路测试技术体系。公司建立了完善的技术研发体系，构建了一支行业经验丰富、专业知识过硬的研发团队。公司由研发中心负责整体研发工作，研发项目开展阶段主要包括项目申请、立项评审、组织实施、项目验收等。

(5) 采用目前经营模式的原因、影响经营模式的关键因素及未来变化趋势

公司专注于提供第三方集成电路测试服务，基于测试服务特性、自身核心技术优势及国家产业政策导向、集成电路产业发展阶段、市场供需格局等形成了契合自身发展需求与行业特征的经营模式。经营模式与行业惯例相一致。报告期内，公司经营模式及影响经营模式的关键因素未发生重大变化。

随着集成电路设计的复杂化以及制造工艺的不断发展，行业专业化、规模化趋势不断凸显，第三方集成电路测试服务商能够聚焦测试技术研发与积累、实现测试环节的规模效应并保持测试结果独立性。随着中国大陆集成电路行业的快速发展，芯片设计、晶圆制造、封装等各环节企业快速崛起，预计独立第三方集成电路测试模式将得到进一步发展。

2、发行人经营业绩稳定、规模较大

发行人深耕第三方集成电路测试服务，经过长期的技术研发与国产工艺适配，与 A 公司等集成电路设计及封装企业建立了稳定的合作关系，经营规模较大、经营业绩稳定。

2023 年度、2024 年度和 2025 年度，发行人营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元；实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 5,902.13 万元、13,358.44 万元和 53,457.09 万元，报告期内业务规模较大、盈利能力稳定，且业绩持续增长。同时，发行人营业收入规模较大，在集成电路测试领域具备较高的市场份额，且已成为最大的内资第三方集成电路测试企业。2025 年度，发行人主营业务收入为 20.33 亿元，在境内第三方集成电路测试服务的市场份额约为 18%，占比较高。

3、发行人是具有代表性的优质企业

公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业，专注于第三方集成电路测试业务，在集成电路国产化、产业链自主可控的浪潮下，为国产高端芯片核心客户及产业链参与方提供芯片成品测试（FT）、晶圆测试（CP）服务。

公司深耕第三方集成电路测试业务，深度参与集成电路国产化和自主可控的历史进程，在时代浪潮中实现了长足发展。随着集成电路产业国产化进程的快速推进，公司不仅是最大的内资第三方集成电路测试企业，也是 2023 至 2025 年度内资第三方集成电路测试领域前五名中增长最快的企业，三年主营业务复合增长率超过 100%。基于在国产化测试工艺、软件系统及国产化测试设备资源等方面的积累和储备，公司已成为国产集成电路产业应对潜在国际政治经济及贸易风险扰动的重要战略选择。

公司始终聚焦装备国产化及客户、产品的高端化，在国产集成电路行业的发

展历程中具有鲜明代表性。

综上所述，公司业务模式成熟、稳定，报告期内经营业绩稳定、规模较大，具有行业代表性，符合主板板块定位。

（二）发行人符合国家产业政策的核查情况

1、公司所处行业不属于国家规定的禁止类行业

公司主营业务为第三方集成电路测试服务。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“C 制造业”门类下的“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”之“C3973 集成电路制造”。

根据国家统计局颁布的《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“1. 新一代信息技术产业”之“1.2 电子核心产业”之“1.2.4 集成电路制造”。根据国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，公司业务覆盖“2.5D、3D 等一种或多种技术集成的先进封装与测试”，属于“鼓励类”行业范畴。

2、公司所处行业受到国家产业政策支持

近年来，国家持续鼓励和支持集成电路产业发展，连续出台了一系列产业政策，为行业发展带来了良好的机遇。2020 年 7 月，国务院出台《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，明确集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量，旨在进一步优化集成电路产业和软件产业发展环境。2024 年 7 月，二十届中央委员会第三次全体会议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，明确抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化包括集成电路在内的重点产业链发展体制机制。一系列产业规划、财税减免、投融资引导等领域的政策法规为集成电路测试行业的发展提供了充分的保障和支持。

综上所述，公司主营业务符合国家相关产业政策。

（三）保荐机构核查程序

1、保荐机构访谈了发行人总经理，了解发行人的业务发展和经营情况、销售模式、生产模式、采购模式、行业地位等；实地查看发行人经营场所，对发行人主营业务及经营情况进行核查；查阅行业研究报告、行业政策与市场研究资料，

对发行人所处行业发展情况进行分析；对发行人的主要客户、供应商进行访谈，了解双方的合作模式和稳定性等；查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，了解发行人的财务情况。

2、保荐机构访谈了发行人总经理，了解发行人的业务发展、经营情况、所处行业及产业情况；查阅了发行人所在行业管理体制和行业政策；获取了发行人住所地主管政府部门出具的合法合规证明。

（四）关于发行人符合主板定位及国家产业政策的核查意见

经核查，本机构认为：

1、发行人业务模式成熟、经营规模较大、经营业绩稳定、具有行业代表性，符合《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》规定的主板定位要求；

2、发行人符合国家产业政策。

四、本次发行符合上市条件

本保荐机构依据《股票上市规则》的相关规定，对发行人是否符合上市条件进行了逐项核查，认为发行人符合《股票上市规则》规定的上市条件，具体情况如下：

（一）发行人符合《股票上市规则》第 3.1.1 条之“（一）符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件”

1、发行人符合《证券法》规定的发行条件

（1）发行人具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十二条第（一）项的规定；

（2）发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第（二）项的规定；

（3）发行人最近三年财务会计文件被出具无保留意见审计报告，符合《证券法》第十二条第（三）项的规定；

（4）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占

财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第（四）项之规定；

（5）保荐机构认为：发行人符合《证券法》第十二条所规定的公司首次公开发行股票条件，符合《证券法》第十二条第（五）项的规定。

2、本次发行符合中国证监会规定的相关条件

保荐机构依据《首发管理办法》，对发行人进行逐项核查，核查意见如下：

（1）发行人符合《首发管理办法》第十条的规定

保荐机构查验了发行人工商档案、《发起人协议》、发行人的公司章程，股东会、董事会会议文件和内部制度文件。发行人前身朗迅有限成立于 2010 年 5 月 14 日，成立时注册资本为 100.00 万元，徐振、孙彬彬、杨晓萍、陈沉、陈玮刚、舒丽霞以货币方式出资。2022 年 9 月 15 日，经朗迅有限股东会决议通过，发行人依法整体变更为杭州朗迅科技股份有限公司。自朗迅有限成立之日起，发行人已经持续经营三年以上，是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。发行人已经依法建立健全股东会、董事会及下属各专门委员会，拟定独立董事、董事会秘书工作制度，具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上所述，发行人符合《首发管理办法》第十条的规定。

（2）发行人符合《首发管理办法》第十一条的规定

保荐机构查阅了发行人的相关财务管理制度，确认发行人会计基础工作规范。项目组查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的发行人最近三年标准无保留意见的审计报告，查阅了发行人重要会计科目明细账、抽查了相关凭证。发行人会计基础工作规范，财务报表的编制和披露符合企业会计准则和相关信息披露规则的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，符合《首发管理办法》第十一条第一款的规定。

保荐机构查阅了发行人的内部控制制度，访谈了发行人的董事、高级管理人员，查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留结论的内部控制审计报告。发行人内部控制制度健全且被有效执行，符合《首发管理办法》第十一

条第二款的规定。

综上，发行人符合《注册管理办法》第十一条的有关规定。

(3) 发行人符合《首发管理办法》第十二条的规定

保荐机构查阅了发行人资产权属证书、财务报告及审计报告、组织机构和职能部门设置情况、内部制度、控股股东及实际控制人控制企业的企业法人营业执照、工商资料、财务报告、银行账户流水等资料，根据发行人相关陈述并同发行人高级管理人员进行访谈，确认发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争以及严重影响独立性或者显失公平的关联交易，符合《首发管理办法》第十二条第一款的规定。

保荐机构查阅了发行人报告期内的主营业务收入构成、重大合同、主要客户及供应商等资料以及工商登记资料、历次董事会和股东会的会议文件，并对发行人实际控制人、董事、高级管理人员及其他股东进行了访谈。经核查，保荐机构认为：发行人主营业务、控制权和管理团队稳定，最近三年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化；发行人的股份权属清晰，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，最近三年实际控制人没有发生变更，符合《首次公开发行股票注册管理办法》第十二条第二款的规定。

保荐机构查阅了发行人的商标证书、专利证书、软件著作权证书等主要资产权属证书，查验发行人审计报告、财务报告、银行账户流水、企业信用报告和中国裁判文书网并根据发行人陈述，确认发行人不存在涉及主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷、重大偿债风险、重大担保、诉讼、仲裁等或有事项。经查验发行人所属行业的行业研究报告、行业规划、相关产业政策并经走访发行人主要客户和供应商，确认发行人不存在经营环境已经或者将要发生的重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项。符合《首发管理办法》第十二条第三款的规定。

(4) 发行人符合《首发管理办法》第十三条的规定

保荐机构查阅了发行人章程、查阅了所属行业相关法律法规和国家产业政策，访谈了发行人高级管理人员，实地查看了发行人生产经营场所，查阅了发行

人的经营范围，该等经营范围已经主管工商部门核准并备案。发行人的生产经营活动符合法律、行政法规和发行人章程的规定，符合国家产业政策，符合《首发管理办法》第十三条第一款的规定。

保荐机构查阅了发行人实际控制人出具的调查表，查看了相关部门出具的发行人、控股股东、实际控制人的信用报告、无犯罪记录证明并进行了网络检索，确认发行人及其控股股东、实际控制人最近三年内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为，符合《首发管理办法》第十三条第二款的规定。

保荐机构查阅了发行人董事、高级管理人员出具的调查表，对董事、高级管理人员进行了访谈并进行了网络检索，确认发行人的董事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查且尚未有明确结论意见等情形，符合《首发管理办法》第十三条第三款的规定。

综上，保荐机构认为，本次证券发行符合中国证监会有关规定。

（二）发行人符合《股票上市规则》第 3.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于五千万元”及“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过四亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”

保荐机构核查了发行人本次首次公开发行股票并上市的董事会议案、决议、股东会议案、决议等资料。发行人本次发行前股本总额为 4,292.1560 万股，本次公开发行股份数量不超过 1,430.7187 万股（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），且不低于发行后股份总数的 25%（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），发行后股本总额为 5,722.8747 万元（不含采用超额配售选择权发行的股份数量），不低于人民币 5,000.00 万元。

综上，保荐机构认为，发行人符合上述规定。

（三）发行人符合《股票上市规则》第 3.1.1 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”

根据《股票上市规则》，公司选择如下具体上市标准：“（一）最近三年净

利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于 2 亿元或者营业收入累计不低于 15 亿元。”

2023 年、2024 年和 2025 年，公司归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低计算）分别为 5,902.13 万元、13,358.44 万元和 53,457.09 万元，最近三年净利润均为正，且累计不低于 2 亿元，最近一年净利润不低于 1 亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为 82,265.23 万元、48,938.12 万元和 175,882.16 万元，累计不低于 2 亿元；营业收入分别为 53,553.63 万元、108,728.04 万元和 206,430.25 万元，累计不低于 15 亿元。符合所选上述上市标准。

（四）发行人符合《股票上市规则》第 3.1.1 条之“（五）本所要求的其他条件”规定

经核查，保荐机构认为：发行人符合深圳证券交易所规定的其他上市条件。

综上，本保荐机构认为发行人符合《股票上市规则》规定的上市条件。

五、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

事项	安排
（一）持续督导事项	在本次发行结束当年的剩余时间以及以后 2 个完整会计年度内对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止控股股东、实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	强化发行人严格执行中国证监会有关规定的意识，协助发行人制订、执行有关制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，确保保荐机构对发行人关联交易事项的知情权，持续关注发行人相关制度的执行情况以及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	协助和督导发行人有效执行并进一步完善内部控制制度；与发行人建立经常性信息沟通机制，持续关注发行人相关制度的执行情况以及履行信息披露义务的情况。
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	督导发行人尽可能避免和减少关联交易，若关联交易为发行人日常经营所必须或者无法避免，督导发行人按照《公司章程》等规定执行，对重大的关联交易本保荐机构将按照公平、独立的原则发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	与发行人建立经常性信息沟通机制，督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定，适时审阅发行人信息披露文件。

事项	安排
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、投资项目的实施等承诺事项	建立与发行人信息沟通渠道，根据募集资金专用账户的管理协议落实监管措施，定期对项目进展情况进行跟踪和督促。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	严格按照中国证监会有关文件的要求规范发行人担保行为的决策程序，要求发行人对所有担保行为与保荐机构进行事前沟通。
（二）保荐协议对保荐人的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作；有充分理由确信发行人或相关当事人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人或相关当事人做出说明并限期纠正，情节严重的，应当向中国证监会、交易所报告；可要求发行人或相关当事人按照法律、行政法规、规章、交易所规则以及协议约定方式，及时通报信息；可列席发行人或相关当事人股东大会、董事会、监事会等有关会议；按照中国证监会、交易所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明。
（三）发行人和其他中介机构配合保荐人履行保荐职责的相关约定	发行人协调相关当事人配合保荐机构的保荐工作，并督促其聘请的其他证券服务机构协助保荐机构做好保荐工作。
（四）其他安排	无。

六、保荐机构和相关保荐代表人的联系方式

保荐机构（主承销商）：广发证券股份有限公司

法定代表人：林传辉

保荐代表人：周天宇、郑睿

联系地址：广东省广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦

邮编：510627

电话：020-66338888

七、保荐机构认为应当说明的其他事项

本保荐机构无其他应当说明的事项。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于杭州朗迅科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市之上市保荐书》之签章页）

项目协办人：

张李展

张李展

保荐代表人：

周天宇

周天宇

郑睿

郑睿

内核负责人：

唐凯

唐凯

保荐业务负责人：

肖雪生

肖雪生

保荐机构总经理：

秦力

秦力

保荐机构法定代表人、董事长：

林传辉

林传辉



2024年9月20日